

Анализ производственного брака и брака комплектующих

Анализ производственного брака и брака комплектующих

Цена:

Цена по запросу

Описание

Технологическая служба осуществляет анализ на своем парке оборудования дефектов пайки, наличие и объем пустот в паянных соединениях микросхем с матричным расположением выводов (пример, компоненты в корпусах BGA, CSP и т.д.), качества пайки выводных компонентов, проверку разварки кристаллов микросхем и т.д. В том числе с применением электронной микроскопии и химического микроанализа шлифов. Визуальная оценка качества паек и трактовка дефектов согласно стандартам IPC. Анализ качества отмывки и загрязнений электронных сборок, проверка уровня кислотности остатков флюса.

Технологическая служба так же оказывает помощь в построении термпрофилей под изделие и на печах оплавления Заказчика.